

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2026-002

广州方邦电子股份有限公司

2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2025 年度实现主营业务收入 33,348.06 万元，与上年同期相比增长 8.63%；2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -7,300 万元至 -11,000 万元。

2、经财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -8,300 万元到 -12,000 万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

公司上年同期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）实现主营业务收入 30,698.69 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -9,164.27 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -11,276.88 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 8.63%，主要是公司研发工作取得阶段性成果，相关新产品逐步贡献收入，其中电阻薄膜（埋阻铜箔）报告期内首度实现量产，取得收入 627.84 万元，同比大幅增长；FCCL 实现收入 3,893.6 万元，同比增长 71.23%。

（二）报告期内，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为 -7,300 万元至 -11,000 万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -8,300

万元到-12,000 万元，主要原因为：（1）新产品逐步放量，其中电阻薄膜（埋阻铜箔）销售额大幅增长，对公司利润形成一定贡献；FCCL 产品销售额同比增加 71.23%，销售规模提升带动固定成本摊薄，FCCL 业务亏损较去年同期有所收窄；（2）铜箔业务结构持续优化，业务毛利亏损有所减少。其中可剥铜通过了相关代表性载板厂商和头部芯片终端的量产认证，持续获得小批量订单，其销售额在本年度持续增长，国产替代趋势愈加突显；此外毛利较高的 RTF 铜箔实现爆发式增长，销售额同比增加 339.45%。（3）可剥铜专项受托开发项目已通过客户结项验收，确认了相应的利润。（4）受铜箔业务持续亏损影响，预计对铜箔相关固定资产组计提减值准备约 2500 万元，较去年同期增加约 1000 万元；同时公司对江苏上达半导体有限公司的投资，其 COF 业务具有良好的发展前景，但由于标的公司实控人违规对外担保导致其背负大额债务，出于财务审慎原则，公司预计计提该笔投资公允价值变动损失约 1500 万元。（5）本期预计计提股权激励费用 823.62 万，预计费用同比增加 510.17 万。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日